

RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/-0.05)

技术规格:

1:电性能

- 1.1 额定电流: 1.0 A
- 1.2 接触阻抗: 30mΩ MAX
- 1.3 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN 500V DC
- 1.4 耐压测试: 500V AC

2:机械性能

- 2.1 插入力: 3.57kgf MAX
- 2.2 拔出力: 1.00kgf MIN
- 2.3 使用寿命: 5000次
- 2.4 耐温性: 烤箱测试: 温度 260±5℃, 时间 5分钟
- 2.5 工作温度: -30℃~+80℃

3:材质及表面处理:

- 3.1 胶芯: LCP 黑色 UL94V-0
- 3.2 端子: C5191, 镍底, 镀金 3.0μ”
- 3.3 外壳: C2680, 表面镀镍 60μ”
- 3.4 符合ROHS的要求



名稱		MICR05P 4J ZB-X	
料號		PART NO.	
圖號		DWG. NO.	
SCALE	1:1	UNIT: mm	A4 SHEET: 1 of 1

General Tolerance	DRAW	繪圖員	李春风	2020. 8. 24
.X ±0.30	DESIGN	設計		
.XX ±0.20	CHECK	校閱	钟华华	2020. 8. 24
.XXX ±0.10	APPRO.	承認	罗孝金	2020. 8. 24
Angle Tolerance				
.X' ±1.0°				
.XX' ±0.5°				
.XXX' ±0.2°				
REV	日期	說明	更改	承認
A	2019/02/15	NEW	吳曉濤	金俊林
ECN(DCN) NO.	DATE	DESCRIPTION	CHANGE	APPRO.



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品编码
Material code:

产品名称 Project:

Micro USB

规格型号 Part No:

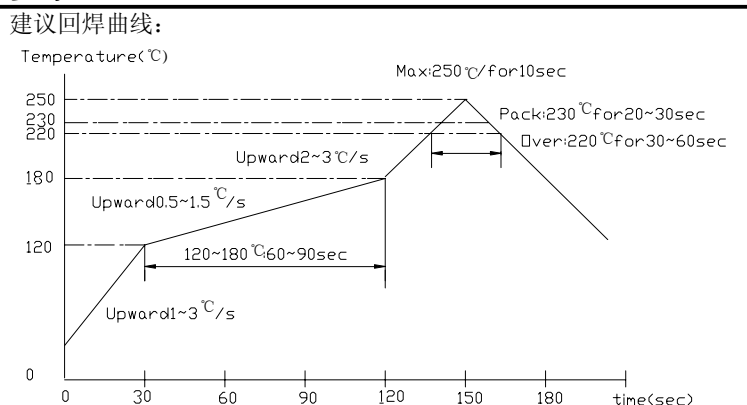
MICR05P 4J ZB-X

贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

1. 物料明细:			
1.1. 塑胶部分: LCP UL94V-0			
1.2. 接触端子部分: C5191R-H, 镍底, 接触部位镀金 1μ”			
1.3. 外壳部分: C2680R-H, 外壳镀镍底 50μ”, 镀锡80μ			
2. 工作条件:			
2.1. 工作电压电流: 30V 1.0Ampere			
2.2. 使用温度: -30℃~+80℃			
3. 电气性能部分			
序号	测试项目	规格和标准	测试方法及参考标准
3.1	接触阻抗	30mΩ MAX	以低功率电流测试产品接触部位阻抗值 参考: EIA 364-23A
3.2	绝缘阻抗	1000MΩ MIN 1000V DC	测试相邻接触脚位之间塑胶阻抗值 参考: EIA 364-21A
3.3	耐压测试	500V AC 1分钟 0.5mA	以 0.5mA 的电流测试接触脚位之间塑胶耐高压 1 分钟 参考: EIA 364-20A
4. 机械性能部分			
4.1	插入力	3.57kgf MAX	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度插入时的力 参考: EIA 364-13A
4.2	拔出力	1.00kgf MIN	与线端匹配时, 线端以 25mm/分速度拔出时的力 参考: EIA 364-13A
4.3	端子单PIN保持力	0.5 kgf MIN	接触 PIN 以 25mm/分速度从塑胶中退出来的力
4.4	寿命测试	1. 产品外观无明显损伤 2. 插入力: 3.0kgf MAX 拔出力: 0.7~1.8 kgf	以每小时 600 次匀速插拔产品 5000 次 参考: EIA 364-09A
4.5	振动测试	10 ⁻⁶ 秒	以每分钟频率由 10HZ 至 55HZ, 再回到 10HZ 为一循环, 连续测试 X/Y/Z 三个方向各 2 小时。 振幅为 1.5mm 参考: EIA 364-28A
5. 环境性能部分			
5.1	沾锡性	吃锡面积达 95%以上	产品焊接区于温度为 235±5℃锡炉中浸泡 5±0.5 秒 参考: MIL STD-202F
5.2	耐高温	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于 85℃的高温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.3	低温性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于-40℃的低温炉中 96 小时后, 再于常温中置放 3 小时后观察。 参考: MIL STD-1344A
5.4	耐湿性	1. 外观无明显损伤 2. 接触阻抗 100mΩ MAX 3. 绝缘阻抗 100MΩ MIN	将产品置于温度为 40±2℃, 湿度为 90~95RH 环境中, 120 小时后观察。 参考: EIA 364-31A
5.5	耐腐蚀性	1. 外观无明显腐蚀 2. 接触阻抗 50mΩ MAX	将产品置放于盐水浓度为 5%, 温度 35±2℃的盐雾箱中连续喷雾 12 小时, 于常温放置 1 小时后观察产品。 参考: EIA 364-26A
5.6	耐焊接性	1. 外观无明显变色、起泡; 2. 焊脚吃锡平滑	建议回焊曲线:  <p>The graph shows a reflow soldering temperature profile. The y-axis is Temperature (°C) from 0 to 250. The x-axis is time (sec) from 0 to 180. The profile starts at 0°C, rises at 1~3°C/s to 120°C (120~180°C for 60~90sec), then rises at 0.5~1.5°C/s to 180°C, then rises at 2~3°C/s to 230°C (Peak: 250°C for 10sec), then rises to 230°C (Pack: 230°C for 20~30sec), then rises to 220°C (Over: 220°C for 30~60sec), and finally cools down.</p>